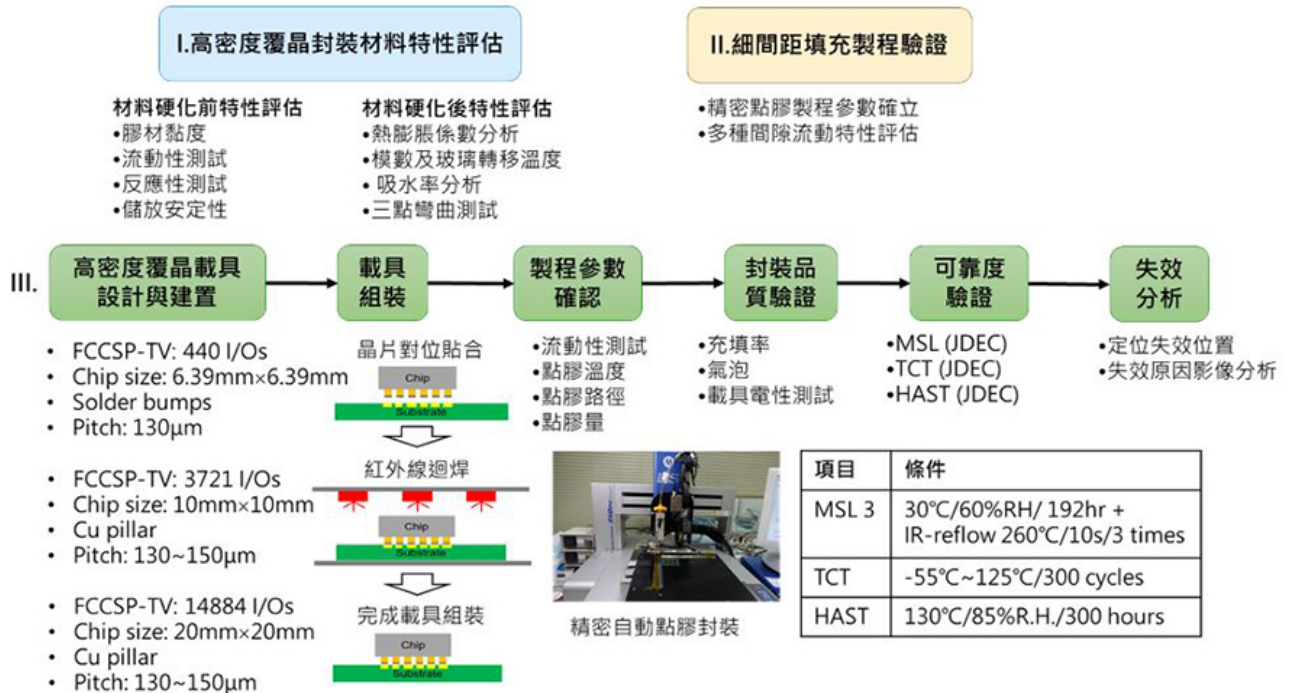


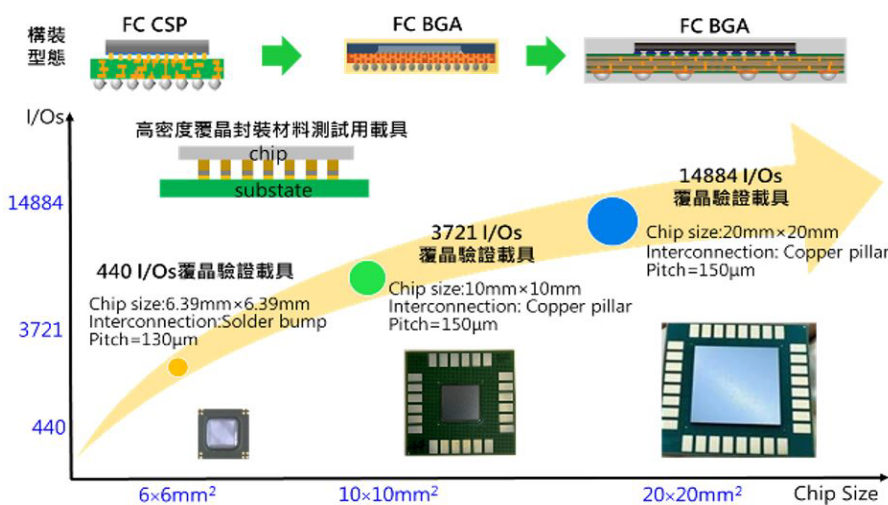
技術簡介

全球電子終端產品日新月異，在電子終端產品需求帶動下，隨著越來越多的功能需求，其晶片的尺寸已有逐漸變大的趨勢，因此具有較多的 I/O 數有望成為新興市場應用的未來發展趨勢。藉由覆晶構裝驗證載具及材料驗證平台，協助材料廠商進行封裝材料製程參數、封裝品調整、封裝品質及可靠度驗證，提供國內材料廠商跨入高階半導體構裝應用領域。

技術特色



技術成果



Implementation Status and Distribution

應用領域

- 智慧型手機等可攜式智慧載具
- 無線通訊應用
- 消費性電子產品應用
- 5G相關應用
- 高速運算應用
- PCB產業..等